

# 苏州昀冢电子科技股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行以“投资者为本”的发展理念，提高上市公司质量，树立良好的市场形象，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，为维护全体股东利益，于 2025 年 4 月制定并披露了公司《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。2025 年度，公司切实履行行动方案有关内容，积极开展和落实相关工作。

为延续 2025 年度行动方案的成果，在 2026 年度更进一步提升公司质量、强化企业市场竞争力、保障投资者权益、助力经济高质量发展，公司特制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

### 一、聚焦经营主业，加快推进新业务

公司主要从事光学领域精密零部件及电子陶瓷、汽车电子等领域产品的研发、设计、生产制造和销售。公司光学领域精密电子零部件产品主要应用在智能手机摄像头中的音圈马达 VCM 和摄像头模组 CCM 中，终端应用于华为、小米、OPPO、VIVO、荣耀等主流品牌智能手机。其中，CMI 系列产品系公司自主研发的集成化产品，在技术工艺水平及市场占有率方面始终保持行业领先地位。

近年来，公司在深耕消费电子主营业务的基础上，稳步推进中长期业务布局与战略拓展。其中，电子陶瓷、汽车电子业务均实现快速增长，为公司构建了韧性更强、结构更优、综合竞争力更为突出的业务生态。在电子陶瓷领域，公司布局的 MLCC 与 DPC 业务实现协同发展，业务增长态势显著。2025 年度，该部分业务营业收入由去年同期的 4,021.28 万元增长至 16,515.05 万元，同比大幅增长 310.69%。公司 MLCC 产品尺寸包括 0201、0402、0603、0805、1206 等，覆盖消费电子、汽车电子、通信及其他工业等多领域市场应用。作为公司中长期策略发展方向，目前公司 MLCC 业务已建立了完善的工艺流程、全面的品质管理体系，且已通过 DNV•GLIS09001/IATF16949 认证。公司持续加速 MLCC 高容量、小尺寸等重点产品的研发，不断提升 MLCC 相关产品的工艺及技术水平，有序推进产品市场化进程。此外，公司 DPC 业务作为电子陶瓷领域的核心拓展方向之一，已自

主开发了预制金锡陶瓷热沉产品，包括预制金锡的氮化铝、碳化硅、T/R 管壳等产品，该类产品具有高耐热、高绝缘性、高导热率等特点，被广泛应用于高功率激光器、激光切割、激光焊接、卫星等领域。在汽车电子领域，公司已通过比亚迪、京西重工、万向精工、捷太格特、拿森汽车、东洋电装等汽车领域客户认证，业务范围覆盖线控底盘制动系统、转向系统以及电子门窗系统，其中，重点布局的线控底盘制动系统领域主要包括 ABS、ESC、ONE BOX 等产品。伴随国内外新能源汽车市场规模持续扩大、技术迭代突破及产业链体系不断完善，公司汽车电子业务有望进一步发展。

2025 年度，公司凭借持续的技术创新能力、扎实的研发积累及在细分领域的领先优势，成功获评国家级专精特新“小巨人”企业。2026 年度，公司将以此为契机，持续强化技术攻关，并通过多举措推进项目发展、优化运营效率，为行业高质量发展贡献力量。

## **二、坚持研发投入，强化研发团队建设，提升科技创新能力**

公司始终高度重视技术创新工作，坚定创新发展理念，将技术创新作为企业在日趋激烈的市场竞争中筑牢发展根基、实现长期可持续发展的核心战略引擎，从资源保障、战略规划、组织实施等多维度予以支撑。2025 年度，公司研发投入 9,539.74 万元，研发投入占营业收入的比例为 16.94%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司共计获得现行有效的发明专利 75 项、实用新型专利 209 项、软件著作权 13 项。2025 年度，公司新增发明专利 18 项、实用新型专利 19 项、软件著作权 1 项。

2026 年度，公司将继续夯实技术基础，提升自主创新能力，加快核心技术升级与关键技术突破。公司将重点围绕电子陶瓷及 CMI 产品开展深度研发与技术攻关，持续打造产品差异化核心竞争力，积极拓展技术应用市场与业务空间，为公司健康发展注入强劲动能。同时，公司将推进专利申请与知识产权保护工作，持续健全内部专利管理体系与管控机制，严格防范知识产权风险，切实维护公司合法权益与创新成果。此外，公司将进一步强化研发人才队伍建设，多渠道引进国内外高端专业技术人才，优化技术人才梯队布局，并通过构建具备市场竞争力的薪酬体系、实施股权激励计划等多元化激励机制，有效吸引、凝聚并稳定优秀专业人才，为企业技术创新与长远发展提供坚实人才保障。

### 三、提高信息披露质量，加强投资者沟通

公司始终对信息披露与投资者关系管理工作予以高度重视。2025 年度，公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。2025 年度，公司通过业绩说明会、投资者热线、上证 e 互动平台、公司官网、微信公众号及邮件等多种形式，与广大投资者构建了常态化、高效化的良性沟通机制。公司于定期报告披露后分别召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会、2025 年第三季度业绩说明会，就报告期内经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。同时，公司积极接听投资者热线电话、100%回复上证 e 互动提问、实时通过官网及微信公众号等平台更新公司新闻资讯。

2026 年度，公司将持续提高信息披露质量、深化投资者关系管理。在提高信息披露质量方面，公司将在依法合规、严谨规范开展信息披露工作的前提下，以投资者实际需求为导向，着力提升信息披露内容的可读性与实用性，通过简化专业表述、完善逻辑层次、丰富信息呈现形式等方式，便于投资者更清晰、更直观地理解公司核心信息。同时，公司将持续强化内幕信息管理，严格落实内幕信息知情人登记等管控要求，严防重要信息泄露及选择性披露行为的发生，切实维护全体投资者平等获取信息的合法权益。在深化投资者关系管理方面，公司将把业绩说明会纳入常态化工作体系，在定期报告发布等重要节点计划召开不少于三场业绩说明会，并通过公司官网、微信公众号等多渠道全面展现公司经营情况与发展前景，构建良好互动生态，增强投资者认同感。此外，公司将持续拓宽沟通渠道、提升沟通频次与互动效果，通过投资者热线、现场调研、公司邮箱等多种方式深化与中小投资者及机构投资者的沟通联络，并及时将投资者诉求与关注重点反馈至经营管理层，充分保障投资者知情权与参与权，形成良性互动机制。

### 四、完善公司治理，提升规范运作水平

公司致力于完善治理结构，不断提升规范化运营水平。2025 年度，为顺应监管政策的更新迭代与公司治理现代化的发展需求，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等一系列相关法律法规的最新规定，推进《公

司章程》及配套议事规则的全面修订工作，取消了监事会设置，进一步强化了董事会审计委员会职能。公司也以此为契机，通过修订、完善一系列内部管理制度，进一步提升了企业运营管理的合规化、精细化水平，为公司规范运作、风险防控及高质量发展奠定了坚实的制度基础。

2026 年度，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和最新监管要求，持续动态优化公司治理结构及相关制度体系。结合市场环境变化与企业发展实际需要，公司将实时对内控流程及配套管理机制进行迭代完善。通过健全权责清晰、运转高效的内部约束体系，不断提升制度执行的刚性与有效性，切实增强公司规范运作水平与风险防控能力，为公司高质量发展提供保障，进而更好地适应资本市场的发展要求，维护公司及全体股东的合法权益。

### **五、关注“关键少数”，强化履职责任**

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的责任意识，要求相关方勤勉尽责、规范履职。2025 年度，公司持续加强与“关键少数”的沟通交流，切实强化其责任意识和担当意识，督促其深入理解并严格落实合法合规履职要求，通过线上与线下相结合的方式完成了有关部门组织的市值管理、上市公司高质量发展等一系列培训。

2026 年度，公司将密切关注监管动态，及时向“关键少数”传达最新监管要求与市场情况，积极组织相关人员参与有关部门开展的各项合规培训，不断强化其合规理念与责任意识，督促其勤勉尽责、规范履职，推动公司治理与运营管理始终合规有序。此外，公司将严格按照《上市公司治理准则》等要求，立足自身经营规模、发展阶段及业务推进等实际情况，科学合理制定董事、高级管理人员的薪酬方案，构建与岗位职责、经营业绩、所处阶段、长期发展相匹配的激励约束机制。公司将持续完善经营管理层与股东的利益共享、风险共担机制，将“关键少数”履职成效与公司长远发展紧密结合，进一步强化董事及高级管理人员的责任意识、合规意识与担当精神，引导其勤勉尽责并聚焦核心业务发展，切实维护公司及全体股东的整体利益，推动企业高质量发展。

### **六、其他事宜**

公司将持续践行 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的相关举措，及时

履行信息披露义务。本次“提质增效重回报”行动方案系基于公司目前经营状况和外部环境所作出，不构成公司对投资者的实质承诺。本次行动方案的实施，未来可能会受到宏观政策、行业竞争、国内外市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

苏州昀冢电子科技股份有限公司

2026年4月20日